

물품 규격(사양)서

※ 특정회사 특정모델만 충족 가능한 규격 불허. 반드시 2개사 이상의 제품이 충족하도록 작성
 ※ 필요시 본 양식이 아닌 다른 양식으로 작성 가능하나, 하기 내용이 빠짐없이 포함되어야 함

부서	전자공학과	연락처	3865	인도조건	현장입고
품명	반도체 die chip	수량	40	단위	개

1. 물품내역

항목	세부사양
형태(모양)	직사각형의 반도체 die 칩
크기	5mm x 6mm
내용	전달하는 설계 정보에 해당하는 반도체 die 칩
재질	-
기타 규격	TSMC 0.18 UM CMOS High Voltage Mixed Signal based General Purpose BCD Dual Gate FSG AL 1P6M 1.8/5/6/8/12/16/20/24/29/36/45/55/65/70V/Vg1.8/5VV [SALICIDE,NBL/PBL,EPI, 1.8/5/6/8/12/16/20/24/29/36/45/55/65/70V/Vg1.8/5VV]
부속품	-

2. 납품조건 (포장, 현장설치 여부 등)

현장 납품

3. 납품기한 (특정일 / 계약일로부터 00일 이내 등)

2020년 3월 11일 Tapeout 시 2020년 5월 30일 이내

4. 납품장소 (구체적인 위치, 00관 00호 등)

아주대학교 원천관 434호

5. 하자보수조건 (무상 하자보수 0년 등)

6. 기타요구사항 (검사검수, 교육 등)